

2021.10.04 新产品发布

实现高良品率·高吞吐量的“对应晶圆焊锡植球设备”开始销售的通知

艾美柯技术株式会社（AIMECHATEC,Ltd.，总部：日本茨城县龙崎市向阳台，社长：阿部猪佐雄）现发布，作为半导体相关事业的新提案，新产品-“对应晶圆焊锡植球设备”开始销售。

本设备是将敝司长期积累的半导体封装基板制造过程中的焊锡球搭载技术应用到晶圆生产工艺上，从而实现高良品率的生产设备。同时，通过对应晶圆的高吞吐量新型搭载头的搭载，大幅度改善了量产生产率和材料使用率。我们通过本设备和对应晶圆检查修补设备的系统化，能够为各位客户提供综合解决方案。

在移动机器等被广泛使用的先进半导体封装FOWLP，WLCSP等的制造过程中，都已采用晶圆全面焊锡球搭载工艺。该工艺，比晶圆切割后植球工艺，在提高生产效率上有很大的优势。目前，对于良品率·吞吐量的要求越来越高，本设备必定会成为各客户的最佳选择。

敝公司愿意通过制程工艺上的不断创新，为了创造更舒适方便，更丰富多彩的生活方式，为社会做出更多的贡献而努力。

咨询：艾美柯技术株式会社
营业部 TEL：0297-62-9119
https://www.ai-mech.com/wp_zh/newproducts/



对应晶圆焊锡植球机(外观)